

電子・先端プロダクツ部門

Electronics & Innovative Products

部門長メッセージ

執行役員
電子・先端プロダクツ部門長

ほり うち ひろ と
堀内 博人

当部門が関わる市場は半導体・xEVなど世界情勢が刻一刻と変化しております。その中で、顧客ニーズを深く理解し、技術トレンドを見極めた上で、当社の得意とする無機／有機の複合技術・熱対策技術・高周波対応技術を駆使し、on timeで最適な素材を市場へ提供していきます。

環境負荷の低減は人類社会全体で解決していくべき課題であることは疑いありません。当部門は、環境負荷低減に寄与する高機能素材の提供を通じて、より良い社会の実現に貢献してまいります。

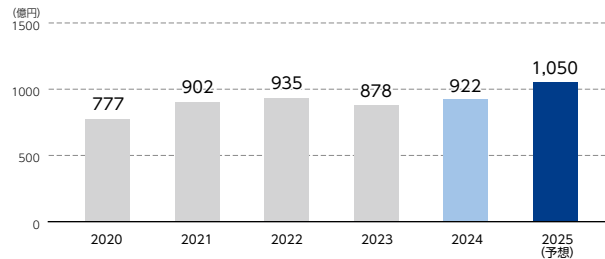
昨年は経営計画「Mission2030」達成に向け、柱となるスネクトンを上市し、量産プラントの設備投資も決定しました。今後も「スペシャリティ」「メガトレンド」「サステナビリティ」の三要素を備えた新製品を投入し、当社を支える核となる事業へと育ててまいります。

経営計画「Mission2030」の目標達成に向けた戦略（「3つ星事業」100%に向けた戦略）

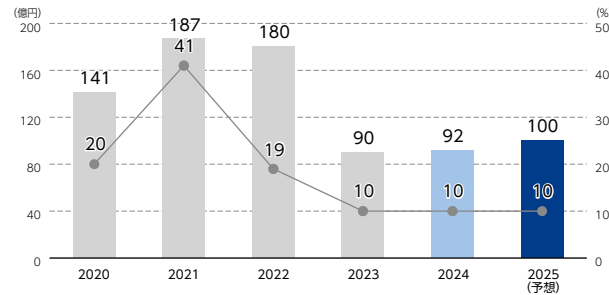
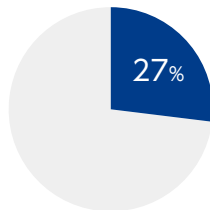
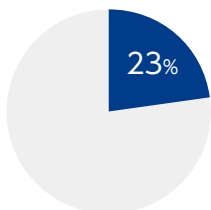
注力分野・マーケット	【主要製品】	【2024年 実績】	【2026年 計画】	【2030年の部門目標】
次世代 高速通信	●球状アルミナ ●低誘電正接シリカ ●低誘電有機絶縁樹脂（スネクトン）	●高速通信機器の銅張積層板・層間絶縁材向けにスネクトン（低誘電有機絶縁樹脂）を上市 ●スネクトンの千葉工場生産プラントの建設投資を決定 ●パワー半導体向けの製造工程用材料として、UV硬化型耐熱仮固定接着剤（TBM）を上市 ●放熱シートの渋川工場を稼働させ生産能力を拡大	●アセチレンブラックのタイ工場を立ち上げ、成長市場であるLiB・高圧ケーブル用途での生産能力を拡大 ●世界シェアNo1の地位を維持強化するため、EVモーターのベアリング用セラミックスボールやセラミック回路基板向けに増強した窒化ケイ素生産設備を本格稼働 ●次世代高速通信の本格立ち上げに伴い、スネクトンの関連市場におけるデファクト化を推進 ●HITTPLATEで高熱伝導グレードの市場導入と実績化 ●半導体製造・検査装置用エミッター新品種の実績化	●メガトレンド分野に同調した“on timeでの継続的な最適素材の開発と提供” ●スペシャリティ製品による圧倒的存在感と当社技術で特徴を出せる市場で素材のデファクト化 ●ESG/SDGs経営によるサステナブルな社会の実現
xEV・ 再生可能 エネルギー	●アセチレンブラック ●球状アルミナ ●窒化ケイ素粉末 ●窒化ケイ素基板	●フラーレン（炭素材料）事業の合併契約を締結し、フラーレンの製造販売事業を行うフロンティアカーボン株式会社の株式50%を三菱商事より取得 ●カラリヤンテープ事業他（大船工場）の撤退決定		

電子・先端プロダクツ部門
Electronics & Innovative Products

売上高推移と見通し



営業利益額/営業利益率推移と見通し

全体売上高に占める割合
(2024年度)従業員数に占める人員割合
(2024年度)

SWOT分析

- 多彩な製品ラインナップによる、幅広い顧客ニーズへの対応
(各種セラミクス素材、高機能有機素材)
- 高い製品シェアによる情報力
- 高温制御技術、窒化技術、球状化技術、焼成技術等の幅広い要素技術

強み S O 機会

弱み W T 脅威

- 急速な市場拡大による設備投資の負担増加
- 商品種が多いことに起因する開発技術力の分散
→ポートフォリオの最適化

- AI、IoTや自動運転など高まる通信の重要性と高速化の進展
- xEV・再生可能エネルギーなど脱炭素社会への潮流

- 新素材によるゲームチェンジの可能性
- 環境対応等に起因する技術開発トレンドの大転換
- 新興国企業をはじめとする競合他社の増加
- 関税コスト増加による価格競争力の低下

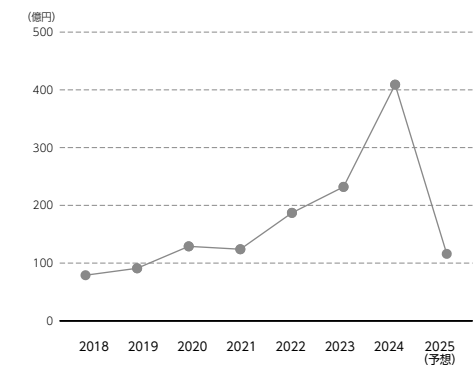
さらなる成長のための「投資」

- ポートフォリオ見直し: 重点製品に設備投資、人員の配置を集中
- スネクトン周辺分野の開拓: 強い製品の派生分野で市場を開拓

既存事業強化での「キャッシュ創出」

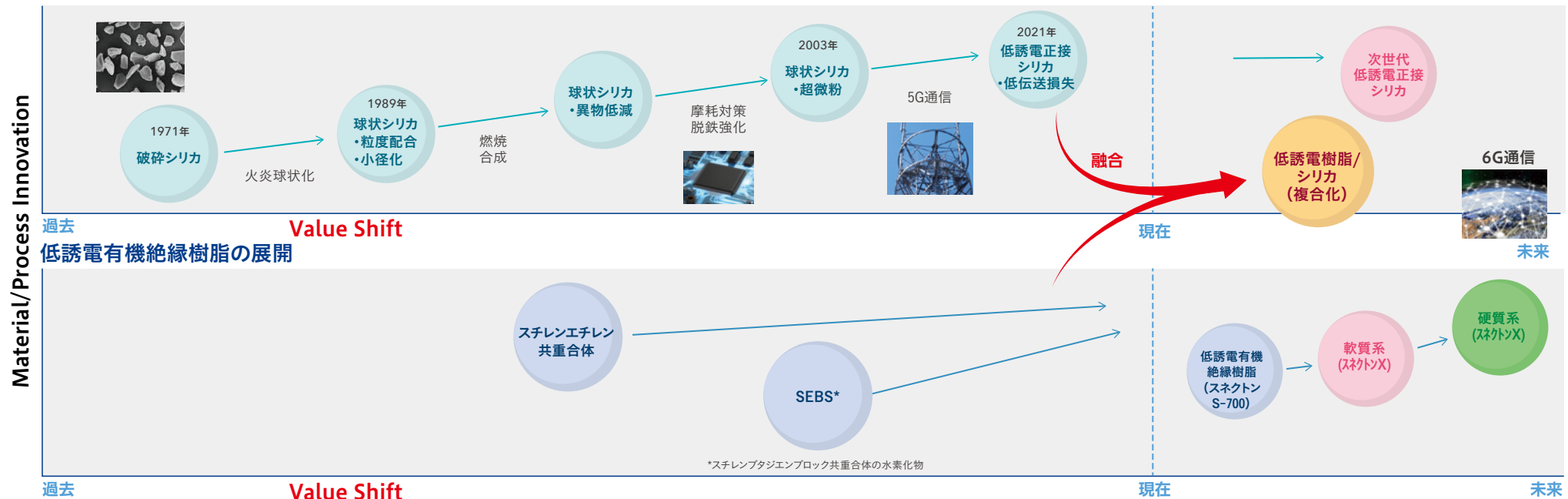
- 電子基板事業強化: 根本から仕組みの見直しを行い収支改善を図る
(セラミックス基板、金属基板)

投資額推移



電子・先端プロダクツ部門
Electronics & Innovative Products

球状シリカの展開



事業を通じた社会への貢献

●低誘電有機絶縁材料「スネクトン」+低誘電正接・低伝送損失シリカフィラー

生成AIの急速な進化と拡大、次世代高速通信 (5G・6G) の普及が目覚ましい中、それらを支えるインフラとしてデータセンターや通信基地局の整備が進んでいます。これらの技術革新を支えるのが高速通信回路基板です。高速通信においては、その電気信号が伝送中に熱に変わってしまう伝送損失を抑える事が非常に重要であり、デンカが持つ配位重合技術を活かし開発された低誘電有機絶縁樹脂「スネクトン」は、その課題を解決できる素材として注目を集めています。

スネクトンはトップクラスの優れた電気特性と架橋性を持っており、さらに銅箔との密着性、吸水率の低さから高い耐久性を実現します。高速通信回路基板は、「軟質材樹脂」+「硬質材樹脂」+「フィラー、ガラスクロスなどの各種材料」によって構成されます。スネクトンは「軟質系」、「硬質系」の両方のグレードをラインナップしており、既に市場で高いシェアを誇るシリカフィラー・各種放熱フィラーなどと融合し、最適な配合でお客さまへ提案できるのは、有機・無機両方の技術を併せ持つデンカならではの強みです。

